

Title (en)

Copper alloy for control cables and connector plugs

Title (de)

Kupferlegierung für Steuerleitungen und Steckverbinder

Title (fr)

Alliage de cuivre pour cables de command et connecteurs à fiches

Publication

EP 0796924 A1 19970924 (DE)

Application

EP 97103190 A 19970227

Priority

DE 19611531 A 19960323

Abstract (en)

Low alloyed copper alloy comprises (wt.%): 0.1 nickel, 0.2-0.5 phosphorus, 0.1-1 iron, and balance copper. Also claimed is an electrical conductor made of the above alloy, and comprising a covering layer of tin, lead, silver, gold, iridium, nickel, platinum, palladium, rhodium, indium, and/or copper and their alloys, with a barrier layer made of nickel or copper between the covering layer and the conductor. The copper alloy contains boron, calcium, or magnesium as deoxidation elements.

Abstract (de)

Eine niedriglegierte Kupferlegierung, die insbesondere für die Herstellung von Steckerstiften und Steuerleitungen einsetzbar ist, besteht vorteilhaft aus einer Legierung aus 0,1 bis 2 Gew% Nickel, 0,2 bis 0,5 Gew% Phosphor, 0,1 bis 1 Gew% Eisen, wobei vorteilhaft auf dieser Legierung eine Mantelschicht u. a. aus Zinn, Blei, Silber, Gold, Platin oder Palladium aufgebracht ist, wobei zwischen der Mantelschicht und der Kernlegierung zusätzlich noch eine Sperrschicht angeordnet sein kann.

IPC 1-7

C22C 9/06; **C22C 9/00**; **H01B 1/02**

IPC 8 full level

C22C 9/06 (2006.01); **H01B 1/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

C22C 9/06 (2013.01); **H01B 1/026** (2013.01)

Citation (search report)

- [XY] EP 0175183 A1 19860326 - OLIN CORP [US]
- [Y] EP 0084937 A1 19830803 - RICHARDSON CHEMICAL CO [US]
- [A] EP 0399070 A1 19901128 - YAZAKI CORP [JP]
- [XY] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 142 (C - 1038) 23 March 1993 (1993-03-23)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 014, no. 149 (C - 0705) 22 March 1990 (1990-03-22)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 581 (C - 1012) 21 December 1992 (1992-12-21)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 108 (C - 280) 11 May 1985 (1985-05-11)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE ES FR GB IE IT LI LU NL PT

DOCDB simple family (publication)

EP 0796924 A1 19970924; DE 19611531 A1 19970925

DOCDB simple family (application)

EP 97103190 A 19970227; DE 19611531 A 19960323